



TECHNOBOND

TAGUNG

4. Tagung Industrielle Klebtechnik

TERMIN 15. - 16. Mai 2019

ORT Stadthalle Bad Hersfeld

LEITUNG Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm
Institut für Produktionstechnik und Logistik
Fachgebiet für Trennende und
Fügende Fertigungsverfahren
Universität Kassel



TECHNOBOND

4. Tagung Industrielle Klebtechnik

TERMIN / ORT

von: 15.05.2019, 09:00 Uhr

bis: 16.05.2019, 16:00 Uhr

Stadthalle Bad Hersfeld

Wittastraße 5, 36251 Bad Hersfeld

LEITUNG

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm

Institut für Produktionstechnik und Logistik

Fachgebiet für Trennende und Fügende Fertigungsverfahren,

Universität Kassel

BEIRAT

› Dipl.-Ing. Julian Band

TC-Kleben GmbH, Übach-Palenberg

› Dr.-Ing. Christoph Eicher

Daimler Buses, EvoBus GmbH, Mannheim

› Bernd Faller

RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG, Zimmern o.R.

› Dr.-Ing. Dirk Hasenberg

3M Deutschland GmbH, Neuss

› Dr. Hartmut Henneken

Jowat SE, Detmold

› Dr.-Ing. Jens Holtmannspötter

Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB), Erding

› Dr.-Ing. Ralf Hose

DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Windach

› Dipl.-Ing. Bernd Maurer

BMW Group, München

› Dr. Thomas Spöttl

Infineon Technologies AG, Regensburg

› Dr.-Ing. Astrid Wagner

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH, Langen

› Dipl.-Phys. Artur Zanotti

Sika Deutschland GmbH, Bad Urach

ZUM THEMA

Ohne die Anwendung der Klebtechnik lassen sich heute viele Produkte nicht oder nicht wirtschaftlich herstellen. In vielen Bereichen, vom Fahrzeugbau über die Elektronik bis in die Medizin, wird die Klebtechnik benötigt, um Werkstoffkombinationen dauerhaft zu verbinden. Ressourceneffizienz und Designfreiheit durch die Klebtechnik werden aber nicht nur im Fahrzeugbau sondern auch im Maschinenbau, in Architektur und im Bauingenieurwesen genutzt. Die Gesetzgebung, neue Werkstoffentwicklungen und wachsende Anforderungen an die Produkte und Produktionsprozesse bedingen eine permanente Weiterentwicklung der Klebtechnik.

ZIELSETZUNG

Die „TechnoBond - 4. Tagung Industrielle Klebtechnik“ bietet Fachleuten und zukünftigen Anwendern die Möglichkeit, sich über das Kleben zu informieren und auszutauschen. Die Erfahrung der Referenten kann genutzt werden, eigene Prozesse besser zu verstehen und zu beherrschen. Best Practice Beispielen verdeutlichen branchenübergreifend die erfolgreiche Umsetzung klebtechnischer Prozesse.

TEILNEHMERKREIS

- › Hersteller von Klebstoffen, Dosiertechnik, Mess- und Prüftechnik, Oberflächentechnik und Analyselabors
- › Mitarbeiter von Hochschulen, Instituten und Forschungseinrichtungen
- › Anwender aus den Bereichen: Automobil-, Nutz- und Schienenfahrzeugbau, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Feinmechanik, Optik und Medizintechnik, Elektronik, Maschinen- und Werkzeugbau, Energieerzeugung, Bauwesen, Holz- und Verbundwerkstoffe, Glas-, Kunststoff- und Metallverarbeitende Industrie, Textilverarbeitung, Verpackungsindustrie
- › Geschäftsführer, Betriebsleiter, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Vorentwicklung, Qualitätssicherung, Fertigung und Fertigungsplanung

HINWEISE

Zimmerkontingent bis sechs Wochen vor der Tagung in folgenden Hotels:

Hotel Thermalis Bad Hersfeld

+49 66 21 - 79 64 90

www.hotelthermalis.de

Hotel am Kurpark

Tel. + 49 (0) 66 21 - 1 64-0

www.hotelamkurpark.net

Mittwoch, 15. Mai 2019, 09:00 bis 18:00 Uhr

09:00 Begrüßung der Teilnehmer

09:10 Themenschwerpunkte TechnoBond 2019

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm

THEMENSCHWERPUNKT 1: „KLEBEN FÜRS LEBEN“

Sitzungsleitung: Dr. Hartmut Henneken

09:20 Einführung durch den Sitzungsleiter

09:30 Kleben zieht an - Kleben oder Nähen?

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm

09:55 Die Kuh, die klebt - Krebsfrei, geruchsarm, resistent gegenüber Umwelteinflüssen

Dr. Sebastian Stappert, GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Greußenheim

10:20 Kaffeepause und Eröffnung der Fach- und Posterausstellung

10:50 Reproduzierbares und zuverlässiges Dosieren und Kleben in der Medizin und Elektronik

Rainer Schobert, John P. Kummer GmbH, Augsburg

11:15 Stärkebasierte Haftschmelzklebstoffe für Pflaster-Anwendungen

Prof. Dr. Thomas Heinze, Friedrich-Schiller-Universität Jena

11:40 Elektrisch leitfähiges Kleben: Klebeflächen als Widerstandsheizung

Sebastian Weyh, Hochschule Schmalkalden

12:05 Mittagspause – Besuch der Fachausstellung

THEMENSCHWERPUNKT 2: „KLEBEN BEWEGT“

Sitzungsleitung: Dr.-Ing. Dirk Hasenberg

13:20 Einführung durch den Sitzungsleiter

13:30 Nah am Wasser geklebt – Kleben maritimer Strukturen

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm

13:55 2K-Kleben in der industriellen Produktion

Alexander Huttenlocher, RAMPF Production Systems, Zimmern

14:20 Industrialisierung der Prozesse beim mediendichten Umspritzen von mechatronischen Komponenten

Fabian Kohler, IMTEK, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

- 14:45 Geklebte Reparaturen für faserverstärkte Kunststoffe - Design und Beständigkeit**
Florian Röper, Polymer Competence Center Leoben GmbH
- 15:10 Kaffeepause - Besuch der Fach- und Posterausstellung**
- 15:35 Optical Bonding im Automobilbereich**
Felix Velten, Dexerials Europe B.V., Frankfurt
- 16:00 Kleben von empfindlichen Kunststoffen - Vermeidung von Spannungsrissebildung**
Dipl.-Chem. David Tobler, Sika Services AG, Zurich, Schweiz
- 16:25 UV vernetzende Epoxytapes**
Dr.-Ing. Johannes Stahl, Lohmann GmbH & Co. KG, Neuwied
- 16:50 Kleben von Strukturbauteilen aus dünnwandigem Magnesium- Druckguss**
M.Sc. Christin Koch, Universität Kassel
- 17:15 Verbesserung der Klebfestigkeit von Kunststoffen durch UV-Laser Vorbehandlung**
M. Sc. Lukas Orf, SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg-Lengfeld
- 17:40 Kurzpräsentation der Poster – anschließend Möglichkeit zur Besichtigung der Poster**

Abendprogramm

- 19:30 Kulinarische Schmankerl im Restaurant „Das Bootshaus“**
- 20:30 Posterprämierung**

Donnerstag, 16. Mai 2019, 08:30 bis 16:30 Uhr

THEMENSCHWERPUNKT 3: „KLEBEN SCHAFFT NEUES“
Sitzungsleitung: Bernd Faller

- 08:30 Einführung durch den Sitzungsleiter**
- 08:40 Einsatz von naturnahen Bindemitteln bei der Herstellung von Holzwerkstoffen**
Dr. Markus Euring, Georg-August-Universität Göttingen
- 09:10 Liquid Factory – Dosierung von Freiformstrukturen**
Thomas Weber, RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG, Zimmern
- 09:35 Innovative punktförmige Verbindungselemente für mechanisch belastete Sandwichstrukturen**
Dipl.-Ing. Sebastian Wagner, NMI Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Universität Tübingen

- 10:00 Kaffeepause - Besuch der Fach- und Posterausstellung**
- 10:25 Überblick über Gebinde und Darreichungsformen von Klebstoffen**
Dr. Hartmut Henneken, JOWAT SE, Detmold
- 10:50 Türsysteme für den Schienenverkehr auf Basis nachhaltiger holzbasierter Materialien**
Andreas Pellegrini, Gebr. Bode GmbH & Co. KG, Kassel
- 11:15 Mittagspause und letzte Möglichkeit zur Ausstellungsbesichtigung**

THEMENSCHWERPUNKT 4: „KLEBEN NACH REGELN“

Sitzungsleitung: Dipl.-Phys. Artur Zanotti

- 12:25 Einführung durch den Sitzungsleiter**
- 12:35 Kleben nach Norm - Ein sicherer Prozess?**
Dipl.-Ing. Günter Schmatz, Ingenieurkonsulent für Kunststofftechnik, Neulengbach, Österreich
- 13:05 DIN 2304 mit Handlungshilfen**
Dipl.-Ing. Julian Band, TechnologieCentrum Kleben, Übach-Palenberg
- 13:30 Strukturkleben im Landmaschinenbau**
M.Eng. Miriam Laubrock, Fachhochschule Münster, Steinfurt
- 13:55 Generatives Fertigen, Industrie 4.0, Recycling und Nachhaltigkeit**
Dipl.-Ing. Nico Bohms, tec-n GmbH, Harzgerode
- 14:20 Kaffeepause**
- 14:40 Sensorischer Klebstoff zur Schadensdetektion im konstruktiven Glasbau – Projekt SENSOTEK**
Dr.-Ing. Mascha Baitinger, Verrotec GmbH, Mainz
- 15:05 Terahertz-Sensorik in der Klebtechnik – Einsatzmöglichkeiten und Grenzen**
Dr. Andreas Winkel, Universität Kassel
- 15:30 Laservorbehandlung vor dem Kleben auf verschiedenen Werkstoffen -Möglichkeiten und Grenzen**
Dipl.-Chem. Marion Gebhardt, ifw - Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH, Jena
- 15:55 Digitalisierung des Reinigungsprozesses mittels QuattroClean**
Dipl.-Ing. Hans-Jörg Wössner, acp systems AG, Ditzingen

16:20 Zusammenfassung und Ausblick

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm

16:30 Ende der Tagung

Die Vortragszeit beträgt 20 Minuten mit anschließender Diskussion von 5 Minuten.

VERANSTALTUNGSNUMMER / KURZTITEL

Veranst.-Nr.: **E-H160-05-043-9**

Kurztitel: **TechnoBond**

TEILNAHMEGEBÜHR

Pro Person:	€ 1.080,00
HDT-Mitglieder und Mitglieder von Partnern:	€ 980,00
Mitarbeiter von Hochschulen, Universitäten, Instituten und Ämtern:	€ 640,00
Referenten von Vorträgen und Posteraussteller:	€ 490,00
Studenten (Nachweis erforderlich):	€ 230,00

mehrwertsteuerfrei, einschließlich veranstaltungsgebundener Arbeitsunterlagen sowie Mittagessen und Pausengetränken

PARTNER

adhäsion KLEBEN+DICHTEN
Das Fachmagazin für industrielle Kleb- und Dichttechnik

CARBON COMPOSITES

CNS
Cluster Nutzfahrzeuge Schwaben

LEICHTBAU
LC
CLUSTER

plasticker
the home of plastics



hdt
WISSEN DURCH ERFAHRUNG

ProMat
Produktbezogene Materialkunde
für technologische Innovation

www.hdt-promat.de

Anmeldung und Veranstaltungsservice

VERANSTALTUNGEN	Alle Veranstaltungen finden Sie unter: www.hdt.de/themen_und_seminare
ANMELDUNG ONLINE	Bei Online-Buchung finden Sie vorausgefüllte Formulare, Hotel- und DB-Ticket-Buchungsmöglichkeit sind in den Anmeldevorgang integriert. E-MAIL anmeldung@hdt.de
ANMELDUNG PER FAX	Eva Gorter TEL +49 (0)201 1803-211 FAX -280 Monica Martins TEL +49 (0)201 1803-212 FAX -280
ANMELDUNG PER POST	Haus der Technik e. V., 45117 Essen
UMBUCHUNG	Umbuchung und Rechnungsänderungen über: E-MAIL umbuchung@hdt.de
HOTELBUCHUNG	Kostenloser Hotelbuchungsservice für alle Veranstaltungsorte: www.hdt.de/hotel E-MAIL hotel@hdt.de
DB-TICKET-BUCHUNG	DB-Ticket-Reservierung Sonderpreis 145,- € 2. Kl. bundesweit: www.hdt.de/bahn E-MAIL bahn@hdt.de Nuri Grohnert TEL +49 (0)201 1803-322 FAX -276

Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne

PROJEKTLEITER	Dipl.-Phys. Helmut Reff	
TECHNISCHE FACHREDAKTION	TEL +49 (0)201 1803-312 FAX -256 E-MAIL h.reff@hdt.de	
BEREICH	Christa Bollinger	
TECHNISCHE FACHREDAKTION	TEL +49 (0)201 1803-271 FAX -256 E-MAIL c.bollinger@hdt.de	

AGB finden Sie unter www.hdt.de/agb

ZAHLUNGSWEISE	Per Überweisung oder per Kreditkarte (VISA, MASTERCARD, AMEX und Diners Club)
UMBUCHUNG ODER STORNIERUNG	Bei Umbuchung oder Stornierung einer Anmeldung kann das HDT eine Gebühr von 50,- € erheben. Diese Gebühr entfällt für HDT-Mitglieder. Für alle Anmeldungen, die nicht schriftlich bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn zurückgezogen werden, muss die Teilnahmegebühr voll berechnet werden.
UMSATZSTEUER	Teilnahmegebühren des HDT e. V. sind gem. § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Quellangaben für Bilder

SONSTIGE	© tff – Universität Kassel
----------	----------------------------

Haus der Technik e. V.

Hollestraße 1
45127 Essen

TELEFON +49 (0)201 1803-1
TELEFAX +49 (0)201 1803-269
E-MAIL hdt@hdt.de

Anmeldungen unter:



www.hdt.de/anmeldung